

证券代码：688516

证券简称：奥特维

无锡奥特维科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	线上参会投资者
时间	2026年5月28日
地点	上证路演中心
上市公司接待人员姓名	联合创始人、董事、副总经理李文先生、董事、董事会秘书周永秀女士、锂电/储能业务负责人张波先生、半导体业务负责人吴文聪先生、证券部张秋仪、缪子健
投资者关系活动主要内容	
	<p>Q：光伏组件多分片技术的后续推广节奏如何？ A：多分片技术目前是光伏提效的主要手段，目前公司已在客户端实现量产应用并获得批量订单，未来多分片技术的应用面将逐步拓展。</p> <p>Q：从龙头光伏设备公司角度判断，光伏行业目前处于什么阶段，预计何时能看到拐点或复苏节奏？ A：光伏行业作为制造业必然存在周期。从公司视角看，目前产能出清尚未彻底完成，仍需一定时间。此次行业调整系生产端产能过剩导致的出清，与此前需求端冲击不同，过程会更漫长。</p> <p>Q：面对2025年及2026Q1光伏业务收入下滑，公司在光伏新技术（如多分片、BC）设备的研发投入与市场拓展计划如何，预计何时能贡献显著收入增长？ A：公司正积极通过技术创新持续布局多分片、OBB串焊机及BC铜浆印刷等设备，OBB技术已在行业实现规模化量产应用，多分片已获客户批量订单。随着OBB、多分片及BC等技术升级推进，预计相关设备有望受益于技术迭代，为收入增长提供新动能。</p> <p>Q：公司对锂电储能客户订单增加需求的持续性如何判断？ A：今年储能行业实现大幅增长，在算力需求和电力需求拉动下，储能电芯一度供不应求。奥特维凭借前期在储能领域的领先布局，储能模组PACK市占率稳步提升。随着全球电力需求和储能需求持续增长，预计行业高景气度将持续至明年甚至后年，公司将凭借整体解决方案和领先产品把握这一轮增长机遇。</p> <p>Q：公司在固态电池上的产品储备和开拓情况如何，能否分产品品类介绍？ A：公司固态电池产品布局分为材料端和制造工艺端两大板块。材料端：硫化物电解质方面，公司产品可覆盖从制粉到干燥的全流程；硅碳负极方面，CVD沉积设备、氧化亚硅气相沉积炉等已交付客户端试用。电池制造工艺端：干法电极方面，公司已推出精密辊压成膜设备；</p>

叠片方面，公司的叠片机设备可实现高精度叠片；软包封装方面，公司已具备相应封装设备；高压模组方面，公司正与客户联合开发高压模组 PACK 设备。

Q: 固态电池技术与公司原有业务如何实现关联协同？

A: 在材料端，硅碳前驱体、CVD 沉积、真空炉等技术与公司光伏单晶炉设备的底层技术相通，仅需针对锂电工艺的要求进行二次应用开发。在电池制造工艺端，固态电池的叠片、封装等工艺与当前电池基本相同，仅在环境适应性和精度要求上有所提升，同属于在原有技术基础上的升级开发。高压模组 PACK 线的技术本质上与现有技术一致，仅在环境特殊性和产品要求上存在差异。

Q: 公司在半导体行业的整体布局思路是什么，未来 2-3 年业务增长潜力如何？

A: 公司半导体业务布局聚焦三大方向：一是深耕功率器件封装领域，电力需求旺盛带动功率器件需求爆发，铝线键合机等设备订单充足；二是持续拓展光通信领域，目前公司光模块 AOI 检测设备已收获客户端批量订单，正规划其他新的产品；三是先进封装领域，公司已围绕 AI 领域启动多项产品规划。业务增长潜力方面，公司功率器件、AI 光通信、先进封装三大领域的设备未来增量较大，叠加公司已有多款产品出货，在业内已形成品牌效应和价值优势，预计未来 2-3 年公司半导体业务有望实现大幅增长。

Q: 公司海外订单情况及对今明两年的展望如何？

A: 公司海外订单占比逐年提升，2024-2025 年占比均达 30%以上，2025 年海外订单接近 20 亿元，其中纯海外客户占比达 70%以上。

Q: 公司通过怎样的体系化技术和人才布局实现跨领域快速拓展？

A: 公司的技术团队体系主要分为三个部分：（1）研发团队：公司每个事业部均配备机电光软的全方位人才，积累不同领域自动化设备经验；（2）技术研究团队：负责通用底层技术研究，为研发提供底层技术支撑；（3）现场服务团队：负责客户端技术调试和信息收集。

此外，公司建立了完善的技术人才任职资格评定和配套培训体系，并设有人才发展中心保障技术人才的培训与成长。公司认为不同行业积累的知识与技术沉淀是公司竞争力的基础，也是实现跨领域技术拓展的根本保障。

日期

2026 年 6 月 1 日